

平成 21 年 4 月 9 日

お客様各位

東京エレクトロニクス株式会社
インレビウム事業部 技術支援部
湯浅 剛

【お詫び】TE8200/TE8201PF 成分表の間違いについて

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたくお礼申し上げます。

さて表題の件につき、この度、当初に提出させて頂いた、当該 IC の成分表の一部部材に間違いがある旨 IC 製造メーカーより連絡がございました。これは、IC 製造メーカーにて当時（2004 年、2005 年）、部品の部材を登録する際に、実際はハロゲンフリーの IC であるに関わらず、誤ってハロゲン有りの他の樹脂情報を登録してしまったためです。

謹んでお詫び申し上げます。

今後このような事が無いように、他の弊社製品を全て今一度再確認の指示をし、再発防止に努めますので、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

敬具

記

1. 該当IC : TE8200PF
 TE8201PF

2. 内容 :

該当ICのIC製造メーカーでの部品登録時（それぞれ2004年、2005年）に、誤って他の樹脂情報（ハロゲン有り）を登録しました。その後のメーカー側での成分表データの見直し（市場よりの新たな各ご要求・法的要求・情報開示の精度向上などによる）により、登録済みデータとの際が発覚しました。

成分表正誤表（添付2枚ご参照）に記載されている、樹脂情報以外の部材については、精度向上によるもので基本的な情報に変更はございません。

3. その他

IC製造メーカーの材料については、常に特性向上に向けて特性改善に取り組んでおりますが、今回の該当ICについては、環境及び品質の観点においてご報告させていただく変更はありません。

写し) インレビウム営業部 部長 千野
インレビウム営業部 グループリーダー 武藤

以上

TE8200PF成分正誤表

No	部位	CAS-NO	物資名	含有量(mg)		含有量(%)	
				旧 成分表	新 成分表	旧 成分表	新 成分表
1	封止材	**	ハロゲン化芳香族炭化水素	3.0327		1.516372	
2	"	1309-64-4	三酸化アンチモン	2.2577		1.128855	
3	"	14464-46-1	シリカフィラー(クリストバル石(SiO ₂))	120.6358	144.727774	60.317903	72.363887
4	"	29690-60-2	エポキシ樹脂	42.5595		21.279752	
5	"	29690-82-2	エポキシ樹脂		23.560335		11.780168
	封止材小計			168.4857	168.288109	84.242882	84.144055
6	リードフレーム	7439-89-6	鉄	0.47	0.47	0.235	0.235
7	"	7440-50-8	銅	19.4885	19.4885	9.74425	9.74425
8	"	7440-66-6	亜鉛	0.025	0.025	0.0125	0.0125
9	"	7723-14-0	燐	0.0165	0.0165	0.00825	0.00825
10	"	7440-22-4	銀		0.005		0.0025
	リードフレーム小計			20	20.005	10	10.0025
11	外部端子処理	7440-31-5	錫	0.98	0.98	0.49	0.49
12	"	7440-69-9	ビスマス	0.02	0.02	0.01	0.01
	外部端子処理小計			1	1	0.5	0.5
13	ブリフォーム	25068-38-6	ビスフェノールA型エポキシ樹脂	0.0762		0.038083	
14	"	9003-36-5	エポキシ樹脂(ビスF)		0.181319		0.090659
15	"	7440-22-4	銀	0.5332	0.77299	0.266579	0.386495
16	"	—	その他	0.1523		0.076165	
	ブリフォーム小計			0.7617	0.954309	0.380827	0.477154
17	配線	7440-57-5	金	1.1403	1.140287	0.570144	0.570144
18	チップ	7440-21-3	シリコン	8.6114	8.611375	4.305688	4.305688
19	"	7440-38-2	ヒ素	0	0.000035	0.000017	0.000017
20	"	7440-42-8	ホウ素	0.0009	0.000885	0.000442	0.000442
	チップ小計			8.6123	8.612295	4.306147	4.306147
	合計	製品質量	200mg	200	200	100	100

TE8201PF成分正誤表

No	部位	CAS-NO	物資名	含有量(mg)		含有量(%)	
				旧 成分表	新 成分表	旧 成分表	新 成分表
1	封止材	**	ハロゲン化芳香族炭化水素	3.0346		1.517293	
2	"	1309-64-4	三酸化アンチモン	2.2591		1.129541	
3	"	14464-46-1	シリカフィラー(クリストパル石(SiO ₂))	120.7091	146.175745	60.354557	73.087872
4	"	29690-60-2	エポキシ樹脂	42.147		21.073518	
5	"	29690-82-2	エポキシ樹脂		23.796052		11.898026
6	"	---	その他	0.4383		0.219165	
	封止材小計			168.5881	169.971797	84.294074	84.985898
7	リードフレーム	7439-89-6	鉄	0.47	0.47	0.235	0.235
8	"	7440-50-8	銅	19.4885	19.4885	9.74425	9.74425
9	"	7440-66-6	亜鉛	0.025	0.025	0.0125	0.0125
10	"	7723-14-0	燐	0.0165	0.0165	0.00825	0.00825
11	"	7440-22-4	銀		0.005		0.0025
	リードフレーム小計			20	20.005	10	10.0025
12	リードフレームメッキ	7440-22-4	銀	0.005		0.0025	
13	外部端子処理	7440-31-5	錫	0.98	0.98	0.49	0.49
14	"	7440-69-9	ビスマス	0.02	0.02	0.01	0.01
	外部端子処理小計			1	1	0.5	0.5
15	ブリフォーム	29690-60-2	エポキシ樹脂	0.1588		0.079393	
16	"	9003-36-5	エポキシ樹脂(ビスF)		0.149407		0.074704
17	"	7440-22-4	銀	1.1115	0.636946	0.555754	0.318473
18	"	---	その他	0.3176		0.158787	
	ブリフォーム小計			1.5879	0.786353	0.793934	0.393177
19	配線	7440-57-5	金	1.1403	1.140287	0.570144	0.570144
20	チップ	7440-21-3	シリコン	7.6779	7.095805	3.838939	3.547902
21	"	7440-38-2	ヒ素	0	0.000029	0.000015	0.000014
22	"	7440-42-8	ホウ素	0.0008	0.000729	0.000394	0.000365
	チップ小計			7.6787	7.096563	3.839348	3.548281
	合計	製品質量	200mg	200	200	100	100